TCHoU-Work Shop

陽子線照射によるPDD構造SOIピクセルセンサの暗電流増加

Increased dark current of PDD structure SOI pixel sensor by proton beam irradiation

<u>鈴木尚紀</u>,倉知郁夫^A,原和彦 筑波大学,高エ研^A



放射線の照射によるセンサへのダメージ

→CMOS Image Sensor(CIS)では暗電流の増加が課題!

暗電流の原因として...

- ▶界面準位の増加
- ▶酸化膜中に発生した電荷による空乏層拡大
- ➤バルク損傷(NIEL)

対策のためにそれぞれの成分の定量的評価したい



PDDTEG2チップを使えば、ピクセル部の暗電流とMOSFETの特性評価による表面準位および 酸化膜内にトラップされた電荷(BOXチャージ)の測定ができる!

<u>SOIピクセル検出器</u>

SOI (Silicon On Insulator) 技術によりSiO2酸化膜上にトランジスタを形成 読み出し回路一体型の次世代半導体検出器



TCHoU-Work Shop

<u>PDD構造 / PDDTEG2 とは?</u>

ピクセル境界の高濃度P型ドープ(BPW)を形成し、この層の 電位(V_{BPW})を固定して用いる ※P型バルクの場合

→BOX回路層とセンサー層の干渉を抑えられる





TEGはPDD構造のPixel Array(センサ部)と、周辺の MOSFETから構成される

Pixel Arrayでセンサ部のリーク電流、MOSFETのIV特 性を測定する

<u>Pixel ArrayとSubMOSFET</u>

◆Pixel Arrayはピクセルサイズ38.4umのピクセルが48*48個

- ◆内側46*46をセンスノード、外側1列をダミーとして区別
- ◆センスノード(S₁,S₂), ダミー, BPW, Psub(裏面)に電圧 をかけてIV測定









◆BOX層をゲート酸化膜としてSubMOSFETを使用 ◆ソース、ドレイン、ゲート、Psub(裏面)のIVを測定

2021/3/30

TCHoU-Work Shop



東北大のCYRIC(cyclotron radio isotope center)にて70MeVの陽子を照射

照射条件は9.63×10¹³ n/cm² ,5.14×10¹⁴ n/cm²の2条件 (1MeV equivalent neutrons/cm2 : n/cm2) 各条件2チップずつ

照射後、冷凍保存 測定前60°C80分のアニールを実施

1.E-04 照射量に依存して暗電流量も大きくなる 1.E-05 Current [A] 1.E-06 →この暗電流増加を 1.E-07 ▶ 界面準位 1.E-08 ► BOXチャージ Reacage 1.E-09 ➤バルク損傷(NIEL) -non radiation 1.E-10 の原因に分けて考えたとき、それぞれの寄与の大きさを評 価したい 1.E-11 1.E-12 50 100 150 200 0 V_{backbias} [V]

<u>MOSFET 評価パラメータ(1)</u>

(1)S:サブスレショールドスイング(slope)

ケート電圧がしきい値電圧より低く半導体表面がわずかしか反転していない場合のドレイン電流はサプスレッショールド電流と呼ばれる

In(Id) – Vgについて、線形領域の傾きをSとして定義する

$$S = \frac{kT}{q} ln 10 \left(1 + \frac{C_D}{C_i} \right) \left(\frac{1 + (C_D + C_{it})/C_i}{1 + C_D/C_i} \right), C_{it} = q D_{it}$$

D_{it}は界面準位濃度

→Sによって界面準位をモニタ





Sを求めた線形近似の外挿からId@midgapのときのゲート電圧をミッドギャップ電圧として定義

◆80°C~300°Cまで20°Cステップで30分間アニーリング →放射線ダメージの回復を見ながら暗電流の原因とな る成分をモニタ

- ◆9.63×10¹³ n/cm² についてはW=20um,L=11umの subMOSFETを測定
- ◆5.14×10¹⁴ n/cm²のサンプルについては@120°Cで L=11um,@160°CでL=9umのSubMOSFETが測定 途中で故障したため160°C~L=7umの SubMOSFETで測定

※比較実験として未照射サンプルについてもアニーリン グを実施 → MOSFET特性に変動なし



2021/3/30

アニーリング

Hisanori Suzuki

<u>PDDTEG 測定結果 ピクセルIV</u>





TCHoU-Work Shop

<u>PDDTEG 測定結果 SubMOSFET</u>



<u>PDDTEGリーク電流とBOX・基板間界面準位の関係</u>



量的にリーク電流の原因のほとんどは界面準位に起因するが、アニールによってバルク損傷によるリーク電流の影響も無視でき ない影響として区別して確認することができた

- ◆PDDTEG2を用いてPDD構造のSOIピクセルセンサーに陽子線を照射し、リーク電流・SubMOSFET特性を測定した →サブスレショールドスイングSによって界面準位を、ミッドギャップ電圧V_{mid}によってBOXチャージをモニタした
- ◆アニール測定によって界面準位とバルク損傷による成分を切り分け、定量的に評価することができた
- ◆BOXチャージの評価には移動度µの適切な推定が必要になるため今後解析を続ける
- ◆放射線の種類の違いによるリーク電流への影響を評価するために高崎でガンマ線照射を行う予定